

# 半导体产业新闻半月刊（精华版）

2019/0520-2019/0602



# 专题分类



## 并购投资

- 点评：
- ①Marvell收购格芯Avera部门，开发ASIC芯片。
  - ②奥普光电拟3.9亿收购光华电子100%股权。
  - ③补救WiFi短板，恩智浦拟收购Marvell通信芯片业务。
  - ④蔚来汽车获北京亦庄国投100亿投资，将在京建制造基地。



领域	时间	事件	原因/内容	资金(美元)
IC制造	2019/05/21	Marvell收购格芯子公司	<b>业务剥离。</b> 此次交易是格芯致力于专注于提供差异化代工厂作为制造服务提供商的核心业务的另一个例子。	7.4亿
IC装备	2019/05/27	奥普光电拟收购光华电子	<b>战略收购。</b> 奥普光电股票自5月27日开市时起开始停牌。	0.57亿
IC封装	2019/05/30	崇达技术拟收购普诺威35%股权	<b>业务拓展。</b> 崇达可借助普诺威在封装载板产品的技术积累,进一步向存储类封装载板和IC封装领域延伸,进入集成电路领域,培育新的业务增长点。	0.12亿
无线连接	2019/05/30	NXP将收购Marvell的无线连接业务	<b>业务增强。</b> 此次收购将使NXP能够向其重点终端市场的客户提供完整、可扩展的处理和连接解决方案。	17.6亿
自动驾驶	2019/05/26	Aurora收购激光雷达公司Blackmore	<b>战略收购。</b> Blackmore的激光扫描技术不仅能探测附近的物体,还能测量物体的运动速度,这种能力非同寻常,对于自动驾驶将非常有益。	
智慧城市	2019/05/28	阿里巴巴拟拿下千方科技15%股权	<b>战略入股。</b> 此次取得千方科技股份系基于对阿里未来发展前景及投资价值的认可。	5.2亿
新能源汽车	2019/05/28	蔚来汽车获亦庄国投投资	<b>战略融资。</b> 亦庄国投将通过其指定的投资公司或联合其他投资方对“蔚来中国”以现金方式出资人民币100亿元,以获取持有“蔚来中国”的非控股股东权益。	14.5亿



## 本土产业

- 点评：
- ①上海集成电路产业投资基金增资积塔半导体。
  - ②5G研究院、5G产业基金落地北京亦庄。
  - ③国家智能传感器创新中心联合实验室在上海正式启用。
  - ④地方产业如火如荼，广州、荆门、苏州、武汉、合肥等地纷纷落地半导体公司。



## 【上海集成电路产业投资基金增资积塔半导体】

近日，上海科创投集团所属上海集成电路产业投资基金股份有限公司、华大半导体有限公司与上海积塔半导体有限公司增资协议签约仪式在积塔半导体临港厂区隆重举行。上海积塔半导体特色工艺生产线项目是市重大工程，总投资为359亿元，是上海市政府与中国电子信息产业集团合作协议的重要内容，也是其中第一个落地的重大产业项目。该项目位于上海浦东新区临港装备产业区，占地面积23万平方米，于去年8月开工，目前基本完成主体工程。

## 【5G研究院、5G产业基金落地北京亦庄】

继北京50%的5G基站部署在北京经济技术开发区后，北京市50亿5G产业基金、5G研究院正式落户北京亦庄。

## 【国家智能传感器创新中心联合实验室在上海正式启用】

5月31日，国家智能传感器创新中心联合实验室正式在上海嘉定区启用，并同期举办智能汽车交流会。上汽乘用车、华为、驭势汽车、上海矽杰、AMS、上海博泰等参与互动交流。

## 【日本电装增资20亿在广州建厂】

5月24日，广州南沙与电装（广州南沙）正式签订《关于电装（广州南沙）有限公司华南新厂区项目投资合作协议书》。电装（广州南沙）将分两期投资不少于20亿元人民币，在黄阁镇新建用地规模约为10万平方米的华南新厂区，提前布局新能源汽车相关产业。



## 【奥士康与肇庆新区管委会签署投资项】

近日，奥士康发布公告，公司与肇庆新区管理委员会签署投资合同，公司拟在香港注册全资子公司香港奥士康公司，并以香港奥士康公司在肇庆新区成立全资子公司肇庆奥士康公司投资兴办项目。该项目名称为“肇庆奥士康科技产业园”项目，投资总额不少于35亿元，主要包括肇庆奥士康印刷电路板生产基地项目以及奥士康华南总部项目，其中生产基地项目主要生产高端汽车电子电路、任意层互联HDI、高端通讯5G网络、高端半导体IC/BGA芯片封装载板、大数据处理存储电子电路等产品。

## 【深圳东飞凌半导体芯片及集成电路封装项目落户荆门】

5月18日，湖北荆门东宝区与深圳东飞凌科技有限公司举行了半导体芯片及集成电路封装项目签约仪式。该项目计划总投资5亿元，将在东宝电子信息产业园建设半导体封测产线，主要进行5G光电芯片封装及集成电路IC封测，产品主要有SOJ（J型引脚外形封装）、TSOP（薄小外形封装）、VSOP（甚小外形封装）、SSOP（缩小型封装）、TSSOP（薄的缩小型SOP）、SOT（小外形晶体管）及SOIC（小外形集成电路），项目达产后预计年产能达1.3亿只，年产值10亿元。

## 【总投资359亿的积塔半导体厂房结构封顶】

5月21日，上海积塔半导体特色工艺生产线项目厂房结构封顶仪式在临港举行。上海积塔半导体项目总投资359亿元，位于上海临港装备产业区，占地面积23万平方米，目标是建设月产能6万片的8英寸生产线和5万片12英寸特色工艺生产线。



## 【硅谷数模全球总部落户苏州高新区】

5月22日，苏州高新区与硅谷数模签署合作协议。硅谷数模计划将其控股母公司——匠芯知本整体迁至苏州高新区，作为未来上市主体以及硅谷数模全球总。根据协议，硅谷数模将在苏州高新区建设全球总部，并计划未来三年在科创板上市。

## 【安徽太湖县首个LED&半导体元器件生产项目开工】

5月22日，安徽太湖经开区2019年招商引资项目第一批集中开工仪式举行，集中开工的项目有7个，总投资20.38亿元，涉及功能膜材料、碳化钛膜、LED半导体元器、精密制造、钣金加工、热流道系统、散热器自动化设备等多个生产领域。

## 【无锡签约拉普拉斯半导体等18个项目】

5月21日，在第二届江苏发展大会无锡行暨第四届全球锡商大会上，签约投资拉普拉斯（无锡）半导体科技有限公司等18个项目，总投资额近413亿元。

## 【武汉京东方10.5代液晶显示生产线厂房建成】

5月21日，在武汉临空港经开区的京东方10.5代液晶显示生产线项目，现代化厂房已经建设完成，当日工艺设备正在搬入。总投资460亿元的京东方10.5代液晶显示生产线项目，总建筑面积142万平方米，主要生产65和75英寸，分辨率8K和4K液晶显示面板。



## 【瑞声科技在常州建光学摄像头模组项目】

5月20日，常州瑞声光学摄像头模组项目在第二届江苏发展大会上签约，该项目预计投资6亿美元。该项目将专门从事模组、传感器以及相关芯片等产品的生产及研发，预计达产后年销售100亿元。

## 【四维图新第二总部落户合肥】

5月24日，合肥高新区与北京四维图新科技股份有限公司签署合作协议，四维图新第二总部正式落户合肥。四维图新第二总部将重点布局自动驾驶、高精度地图、高精度定位、汽车电子芯片等业务。

## 【正威国际光电显示偏光板产业基地落户海安】

5月22日，江苏省海安市在深圳举行正威国际集团（海安）光电显示偏光板产业基地项目签约仪式。此次签约的光电显示偏光板产业基地项目总投资约100亿元。项目分三期建设，一期、二期总投资约50亿元，新上4条TFT-LCD等级偏光板生产线，建设年产8400万平方米TFT等级偏光片项目。三期为产业链后续上下游配套项目，预计总投资50亿元，基地全部建成后可实现年销售额150亿元。



## 【安徽巢湖签约、开工一批重大项目】

5月25日上午，2019年安徽巢湖经开区举行了高质量发展项目集中签约暨集中开工活动。此次集中签约项目共70个，总投资651.7亿元，集中开工项目43个，总投资257.57亿元，涉及高端装备制造、新能源、新材料、生物制药、电子信息等多个产业领域。

## 【苏州签约博世MEMS传感器和半导体芯片测试中心等15个项目】

5月21日，第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会·苏州活动在苏州举行。活动现场，15个重大项目集中签约，总投资达172亿元人民币，其中包括博世汽车部件MEMS传感器和半导体芯片测试中心项目。

## 【中环股份拟投建太阳能电池用单晶硅材料项目】

中环股份公司控股子公司内蒙古中环协鑫拟投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目，新增产能25GW，建成后“中环产业园”整体产能将达到55GW以上，成为全球最大的高效太阳能用单晶硅生产基地。

## 【TCL集团将在深圳建两条第11代新型产线】

近日，丘钛科技（集团）有限公司总投资6亿美元的高清摄像头模组及汽车摄像头模组项目顺利落地。此次增资完成后，丘钛科技在高新区的总投资额达到10.89亿美元，成为已投产单体投资规模最大的外资企业项目。



## 市场数据

- 点评：
- ①预计2019年全球功率芯片销售达171亿美元续创新高。
  - ②Q1存储器产值环比减少27%，同比重挫30%。
  - ③第一季度全球前十封测厂出炉，前八名营收皆明显下滑。
  - ④Q1全球电视品牌出货排名出炉，小米窜升至第五。



# 【周期性低迷即将结束？IC市场第三季度或将强劲反弹】

## Periods of Three Sequential Quarterly IC Market Declines

Period	Year	1Q	2Q	3Q	4Q	Annual
1	1981	-8%	-1%	-2%		10%
2	1985	-18%	-8%	-8%		-19%
3	1996	-9%	-14%	-3%		-9%
4	1997				-3%	4%
	1998	-10%	-6%			-9%
5	2001	-20%	-20%	-11%		-33%
6	2018				-9%	14%
	2019	-18%	-1%*			-13%*

\*Forecast

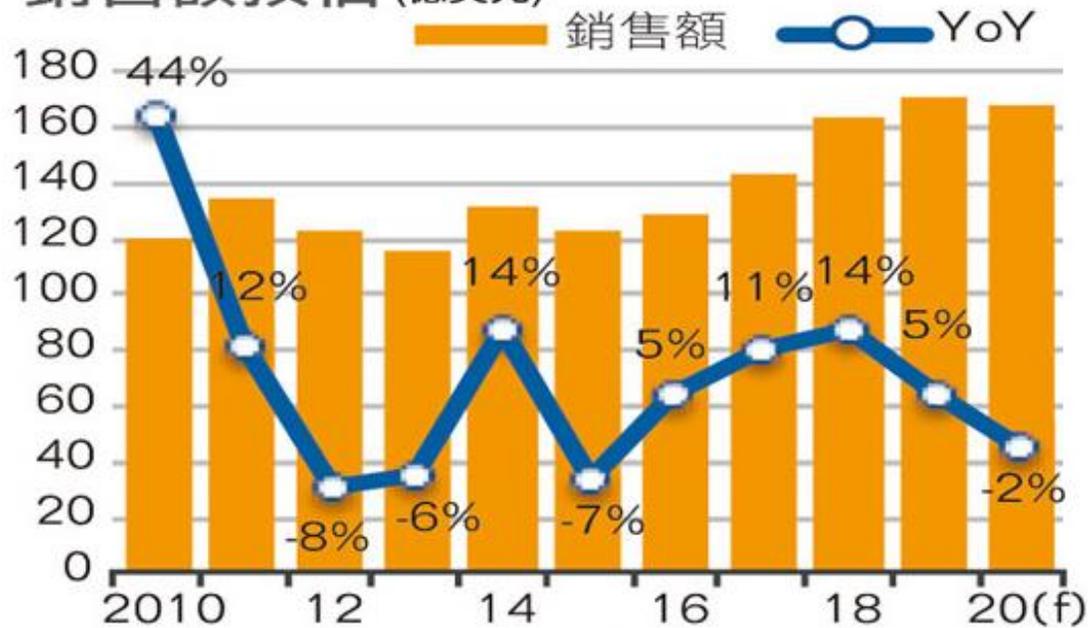
Source: WSTS, IC Insights

IC Insights表示，拥有长达60年历史的半导体行业，具有很强的周期性。回溯至20世纪70年代中期，IC市场从未经历过连续四个季度下滑的时期。预计今年第二季度的IC市场环比下降1%，那么这就意味着IC市场将经历第6次连续三季度环比下降。



【2019年全球功率芯片销售达171亿美元续创新高】

2010~2020年全球功率電晶體  
銷售額預估 (億美元)



資料來源：IC Insights，DIGITIMES整理，2019/5

受到全球经济增长放缓、中国大陆与美国贸易战日益激烈，以及预期2020年初终端设备市场需求成长将会下滑等因素影响，预估2019年全球功率芯片销售额续创新高，达171亿美元。



## 【2019年Q1存储产值环比减少27%，同比重摔30%】

No.	Maker	M.S.	Q1'19	Q4'18	QoQ%
1	Samsung	45.0%	6,931	9,621	-28.0%
2	SK Hynix	29.2%	4,875	7,138	-31.7%
3	Micon	21.2%	3,760	5,373	-30.0%
4	NanyaTech	2.8%	369	550	-32.9%
5	Winbond	0.7%	148	157	-5.3%
6	Powerchip	0.3%	65	79	-18.4%
7	ESMT	0.3%	62	65	-4.6%
8	ISSI	0.2%	66	63	4.3%
9	Etron	0.1%	21	25	-14.5%
	Others	0.1%	11	15	-26.7%
	<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>16,307</b>	<b>23,086</b>	<b>-29.4%</b>

Copyright © CINNO Research Unit: \$USD/ Million

No.	Maker	M.S.	Q1'19	Q4'18	QoQ%
1	Samsung	30.5%	3,261	4,123	-20.9%
2	Toshiba	18.8%	2,015	2,689	-25.1%
3	Micron	16.6%	1,776	2,179	-18.5%
4	Western Digital	15.1%	1,610	2,173	-25.9%
5	SK Hynix	9.6%	1,023	1,586	-35.5%
6	Intel	8.6%	915	1,107	-17.3%
7	Cypress	0.3%	32	30	6.5%
8	Macronix	0.2%	22	28	-20.3%
9	Winbond	0.2%	20	21	-7.1%
	Others	0.1%	15	17	-15.0%
	<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,689</b>	<b>13,954</b>	<b>-23.4%</b>

Copyright © CINNO Research Unit: \$USD/ Million

No.	Maker	M.S.	Q1'19	Q4'18	QoQ%
1	Cypress	23.1%	127	147	-13.5%
2	Macronix	21.2%	116	120	-3.3%
3	Winbond	20.4%	112	124	-9.3%
4	Micron	16.4%	90	120	-25.0%
5	GigaDevice	9.6%	53	58	-8.6%
6	ISSI	2.2%	12	12	-4.6%
7	ESMT	1.5%	9	13	-35.0%
	Others	5.7%	31	33	-4.9%
	<b>Total</b>	<b>100.0%</b>	<b>550</b>	<b>627</b>	<b>-12.3%</b>

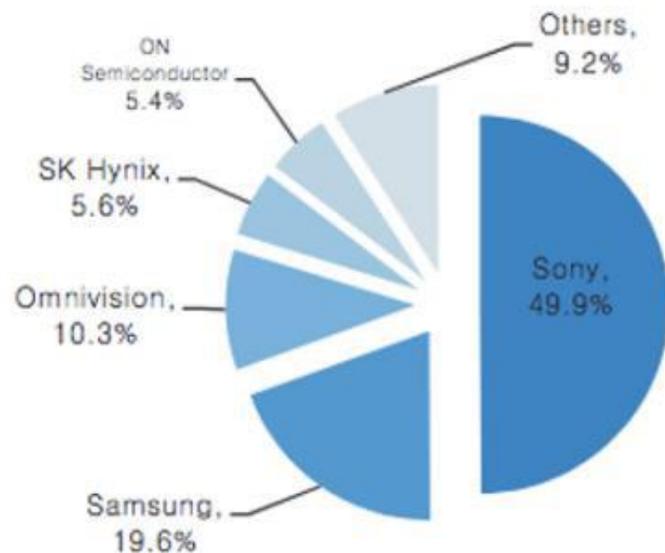
Copyright © CINNO Research Unit: \$USD/ Million

据统计，第一季整体存储行业的产值达到275.4亿美元，较去年第四季同期减少27%外，同比更是重重的衰退了30%，创下近七年来衰退幅度最高的一个季度，全存储行业持续面临收缩格局。



## 【全球CMOS图像传感器厂商最新排名：索尼第一】

2018년 기준 글로벌 CIS 시장 점유율



자료: 유안타증권 리서치센터

半导体行业观察

台湾地区的Yuanta Research称，2018年全球CMOS图像传感器的市场规模为137亿美元，其中，索尼的市场占有率为49.9%，排在行业第一，而且地位得到了进一步的巩固；三星排名第二，市占率为19.6%，豪威科技排名第三，市占率达到10.3%，而有些出人意料的是，SK海力士排在了第四位，安森美排在第五位。



# 【第一季度全球前十封测厂出炉，前八名营收皆明显下滑】

表、2019年第一季全球前十大封测业者排名 (单位：百万美元)

排名	公司	1Q18 营收	1Q19 营收(E)	1Q19 市占率(E)	1Q19 营收年增率(E)
1	日月光	1,204	1,116	19.7%	-7.3%
2	艾克尔	1,025	895	15.8%	-12.7%
3	江苏长电	864	666	11.8%	-22.8%
4	矽品	650	600	10.6%	-7.7%
5	力成	547	469	8.3%	-14.2%
6	天水华天	303	253	4.5%	-16.7%
7	通富微电	258	218	3.8%	-15.6%
9	联测	201	174	3.1%	-13.3%
8	京元电	157	171	3.0%	8.6%
10	颀邦	132	152	2.7%	14.7%

注一：为日月光投控封装与测试占比营收，并扣除矽品营收后之数值

注二：通富微电营收为预估值

数据来源：拓璞产业研究院，2019年5月

集邦咨询旗下拓璞产业研究院公布了2019年第一季度全球十大封测厂排名，日月光以11.16亿美元的营收排在第一，位列第二和第三的艾克尔和江苏长电第一季度营收都遭遇了两位数下滑。



## 【四月北美半导体设备出货19.1亿美元，年减29%】

	Billings (3-mo. avg.)	Year-Over-Year
November 2018	\$1,943.6	-5.3%
December 2018	\$2,104.0	-12.3%
January 2019	\$1,896.3	-20.0%
February 2019	\$1,868.1	-22.7%
March 2019 (final)	\$1,825.3	-24.9%
April 2019 (prelim)	\$1,910.8	-29.0%

Source: SEMI (www.semi.org), May 2019

SEMI近日公布4月北美半导体设备制造商出货报告，相关金额较3月小幅回升，终止连三跌。不过美中贸易战延烧，半导体产业屡遭波及，业界也传出，不少半导体厂已下修第3季业绩增长预估。



## 【Q1全球电视品牌出货排名出炉，小米窜升至第五】

表、2019年第一季度全球电视品牌出货排名

品牌厂	1Q19		4Q18		QoQ	YoY
	排名	出货量	排名	出货量		
三星	1	9.42	1	11.95	-21.2%	-5.8%
乐金电子	2	6.50	2	8.40	-22.6%	-7.1%
TCL	3	5.69	3	5.22	9.0%	43.1%
海信	4	3.03	4	3.63	-16.5%	-6.8%
小米	5	2.85	6	3.16	-9.8%	93.9%
创维	6	2.35	7	3.05	-23.0%	6.8%
Sony	7	2.10	5	3.90	-46.2%	-16.7%
其他	17.93		26.83		-33.2%	-6.6%
出货总量 单位:百万台	49.87		66.14		-24.6%	0.5%

Source: TrendForce, May, 2019

WitsView最新研究报告显示，2019年第一季度全球电视品牌出货数量为4987万台，季减24.6%，年增0.5%。由品牌出货排名可以发现，除了一、二名仍由韩系品牌占据，第三到第六名皆为中国品牌，显示中国品牌利用成本优势积极提升市占率的势头不可小觑。



## 【2018年中国LED封装市场全球厂商营收排行榜出炉】

表一：2017-2018年中国市场LED封装前十大厂商营收排名

排名	2017前十大厂商	2018前十大厂商	变化
1	木林森	木林森	→
2	日亚化学	日亚化学	→
3	Lumileds	欧司朗光电	↑
4	欧司朗光电	Lumileds	↓
5	亿光	国星	↑
6	国星	亿光	↓
7	光宝	鸿利	↑
8	首尔半导体	首尔半导体	→
9	鸿利	聚飞	↑
10	聚飞	光宝	↓

数据源：LEDinside, May 2019

LEDinside最新《2019中国LED芯片与封装产业市场报告》显示，2018年中国LED封装市场规模为105亿美金，同比增长4.5%。



## 【TWS蓝牙耳机市场今年预计增长52.9%】



随着蓝牙5.0的问世，解决了TWS蓝牙耳机的传输与耗电问题，加上Apple推出AirPods后市场快速成长。2019年Samsung、Sony、华为、小米等手机品牌厂也相继推出TWS蓝牙耳机，预计将带动今年TWS蓝牙耳机出货量达7,800万组，年增52.9%。



## 产业合作

- 点评：
- ①Ams与OPPO深化战略合作，点燃手机创新新引擎。
  - ②Ams、Ibeo和采埃孚强强联合，确保固态激光雷达技术能够更快得到应用。
  - ③华为与珠海签订人工智能与云计算合作协议。打造AI创新中心。



领域	合作公司/单位	目的
传感器	Ams、OPPO	深化战略合作，点燃手机创新新引擎。
激光雷达	ams、Ibeo、采埃孚	三家公司将合作开展联合研发工作，以确保这项激动人心的固态激光雷达技术能够更快、更安全的在2021年得到应用。
AI	华为、珠海市	双方将在人工智能创新及应用、云计算及数据服务、人才交流及培养等领域展开深入合作，打造华为公司在大湾区及珠江西岸重要的人工智能领域的创新中心。
摄像头模组	桂林电子科技大学、昆山丘钛微电子科技	双方签订战略合作协议目的是培养创新人才，有助于学校与企业加强交流互动，优势互补，资源共享，形成良性的战略合作关系。



## 设计制造

- 点评：
- ①台积电二代7nm+工艺已量产。
  - ②英特尔10纳米处理器已量产出货。
  - ③ARM发布全新CPU架构。



## 【台积电二代7nm+工艺已量产】

台积电官方宣布，已经开始批量生产7nm N7+工艺，这是台积电第一次、也是行业第一次量产EUV极紫外光刻技术，意义非凡，也领先Intel、三星一大步。

## 【英特尔：10纳米处理器已量产出货】

芯片大厂英特尔资深副总裁Gregory Bryant近日在COMPUTEX 2019英特尔开幕主题演讲上证实，采用10纳米制程的第10代Intel Core处理器已量产出货，OEM机种则预估年底前推出。

## 【ARM发布全新CPU架构】

近日ARM发布最新CPU架构A77。A77是基于A76架构的改进版，7nm工艺下，目标频率3GHz，同频3GHz性能相比A76架构有20%的提升。

## 【英飞凌扩展Graz研发中心】

德国英飞凌正在进行扩张。位于奥地利格拉茨（Graz）的英飞凌研发中心正在新一轮建设中，这项工程将为另外290个研发工作场所提供空间。



## 产品应用

点评：①5G、AI、导航芯片、传感器领域火热，各厂商纷纷推出新产品。



领域	公司/单位	产品及特性
AI开发平台	瑞芯微	面向全球AI开发者发布三大开发套件：AI开发工具包RKNN-Toolkit、AI SDK软件开发工具包Rock-X SDK，以及AI人工智能计算棒RK1808 AI Compute Stick。
定位芯片	北斗星通	布局开发22nm高精度车规级定位芯片Nebulas-IV和22nm超低功耗双频双核定位芯片Firebird-II。
导航芯片	北京合众思壮科技	发布针对北斗三号系统研发的天琴二代基带芯片，以及基于天琴二代基带芯片和天鹰射频芯片的高精度板卡。
耳机芯片	紫光展锐	推出TWS真无线蓝牙耳机芯片—紫光展锐春藤5882，该芯片支持蓝牙5.0，可实现超低功耗、超低时延，为用户提供高品质的双主耳体验。
5G	NI	宣布推出毫米波矢量信号收发仪（VST），以解决5G毫米波RFIC收发仪和功率放大器带来的测试挑战。
5G	ADI	推出一款面向毫米波5G基础设施的新型解决方案，该解决方案拥有目前最高的集成度，旨在降低下一代蜂窝网络基础设施的设计要求和复杂性。
传感器	博世	发布了适用于飞行汽车的新传感器平台，能够以较低的成本为飞行出租车行业提供所需的零件。
传感器	思特威	推出SC8238 CMOS图像传感器，开启4K消费级视频应用新时代。
传感器	OmniVision	发布用于汽车可视应用的下一代1MP图像传感器OX01D10。该传感器集成了分割像素和双转换增益（DCG）技术，可提供无伪影运动捕捉，高达120dB的高动态范围（HDR）以及LED闪烁抑制（LFM）。
传感器	ADI	ADI 宣布推出用于生物和化学感测的新型阻抗和恒电位仪模拟前端。
显示器	Plessey、JDC	全球首款GaN-on-Silicon 0.7吋单片全高清显示屏推出。
相机	三星	研发了一款超薄光学5倍变焦相机模块。
PC	高通、联想	亮相全球首款5G笔电，产品搭载高通Snapdragon 8cx平台，强调优越的性能及电池续航力。

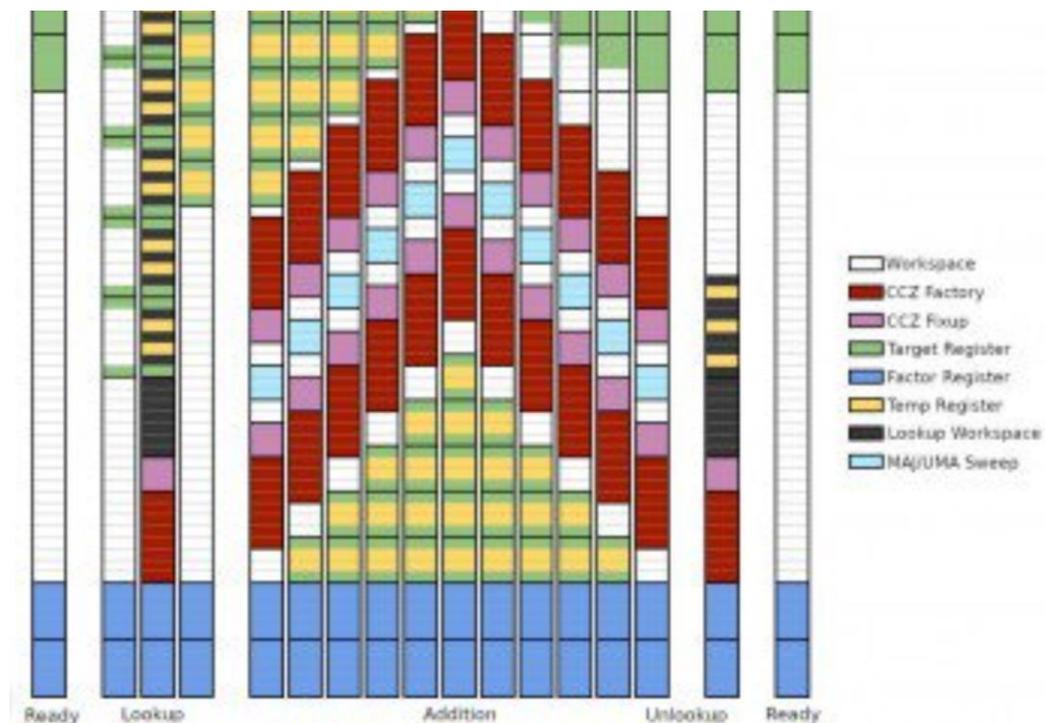


# 科技前沿

点评：①谷歌最新研究：量子计算机能在8小时内破解2048位RSA加密。  
②复旦科学家发明新的单晶体管逻辑结构。



# 【谷歌最新研究：量子计算机能在8小时内破解2048位RSA加密】



谷歌的 Craig Gidney 和瑞典斯德哥尔摩 KTH 皇家理工学院的 Martin Ekerå 的研究人员已经找到了一种更有效的方式，让量子计算机执行代码破解计算，从而将量子计算机所需的资源减少了几数量级。



## 【台成功大学发表光控多位元存储器材料】

- ① 台成功大学物理系研究团队最新发表存储器新材料「铁酸铋(BiFeO<sub>3</sub>)」操控方式。
- ② 研究团队表示，团队所提出的关键光控技术，可利用光照产生的局部形变进而控制铁酸铋中的多位元存储组态。利用光学写入技术的存储器不需任何借助任何金属电极与复杂的元件制程，充分体现“材料即元件”的构想，不只提升了信息存储效益，也为新一代存储器开发带来全新的思考方式，使该材料可被直接导入如量子储存，量子通讯等结合尖端光学技术的跨领域科技。

## 【我国科学家发明新的单晶体管逻辑结构】

复旦大学科研团队近日在集成电路基础研究领域取得一项突破。他们发明了让单晶体管“一个人干两个人的活”的新逻辑结构，使晶体管面积缩小50%，存储计算的同步性也进一步提升。

## 【麻省理工学院开发低成本传感器手套：使机械手触摸识别物体】

麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(MIT-CSAIL)的研究人员近日开发了一种低成本的传感器手套，旨在使人工智能能够“弄清楚”人类如何通过触摸识别物体。它被称为可伸缩的TActive手套(STAG)，使用550个微小的压力传感器来生成可用于创建改进的机械手的模式。



## 焦点关注

- 点评：
- ①美科技巨头相继停止对华为供货、IEEE禁止华为员工参与审稿。
  - ②国务院发布白皮书：披露美国三次出尔反尔，表明中方经贸磋商立场。
  - ③商务部：中国将建立不可靠实体清单制度。
  - ④财政部、税务总局：集成电路设计和软件企业免征两年企业所得税。



## 【美科技巨头相继停止对华为供货】

高通、谷歌、ARM、微软、英特尔、Qorvo、SD联盟、wifi联盟、陶氏化学等单位先后响应美国商务部号召，与美国政府沆瀣一气，纷纷宣布对华为公司断供。

## 【IEEE禁止华为员工参与审稿】

近日，一段IEEE 内部发给期刊主编的部分邮件内容被曝光，所设规定危及学术交流。邮件指出，由于美国政府已经将华为列入了美国商务部工业安全局(BIS)实体名单中，同时，根据IEEE内部文件的常见问题回答(FAQ)页条款，**IEEE要求其期刊主编不能让有华为背景的的评审人员或编辑作为杂志同行评议的一员**。邮件还指出，IEEE 似乎允许让有华为背景的员工继续在编辑部任职，但他们不能处理任何文献，除非美国商务部工业安全局(BIS)将华为从其实体名单中移除。



## 【国务院发布白皮书：披露美国三次出尔反尔，表明中方立场】

- ① 继去年9月发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书后，中方再度就中美经贸问题发表白皮书。
- ② 国务院新闻办公室6月2日发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，旨在全面介绍中美经贸磋商基本情况，阐明中国对中美经贸磋商的政策立场。
- ③ 此次白皮书全文约8300字，除前言和结束语外，共包括三部分，分别是美国挑起对华经贸摩擦损害两国和全球利益，美国在中美经贸磋商中出尔反尔、不讲诚信，中国始终坚持平等、互利、诚信的磋商立场。
- ④ 白皮书披露了美国的三次出尔反尔，并强调中国态度。白皮书表示，中国的态度是一贯的、明确的。中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。对于两国经贸分歧和摩擦，中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国决不让步。对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。



## 【中国将建立“不可靠实体清单”制度】

商务部新闻发言人高峰表示，根据相关法律法规，中国将建立不可靠实体清单，对不遵守市场规则，背离契约精神，出于非商业对中国企业实施封锁或断供，严重损害中国企业正当权益的外国企业组织或个人，将列入不可靠实体清单。具体措施将于近期公布。

## 【中国正式立案调查联邦快递】

最近，美国联邦快递在我国发生未按名址投递快件行为，严重损害用户合法权益，已违反我国快递业有关法规。国家有关部门决定立案调查。

## 【第二批科创板IPO上会企业出炉：睿创微纳、福光股份、华兴源创在列】

5月30日，上海证券交易所发布科创板上市委2019年第2次审议会议公告，将于6月11日审议福光股份、华兴源创、睿创微纳3家企业的发行上市申请，其中睿创微纳为科创板首批受理企业之一。



## 【中芯国际宣布申请从纽交所退市】

- ① 5月24日晚间，中芯国际发布关于拟将美国预托证券股份从纽约证券交易所退市和撤销根据美国证券交易法之注册及终止申报责任的海外监管公告。
- ② 关于从纽交所降级的原因主要体现在以下几方面，中芯国际表示，此次主动申请有多种原因，其中包括：与全球交易量相比，中芯国际ADS交易量相对有限；以及维持ADS在纽约证券交易所上市将带来较重的行政负担和较高的成本等。

## 【集成电路设计企业免两年企业所得税】

财政部、税务总局近日发布公告，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。



## 专利要闻

点评：①智能手机、指纹识别、新型显示器领域竞争激烈，龙头企业竞相申请新专利。



类别	公司/单位	事件内容
新专利	苹果	新专利：通过检测优势眼来改善VR、AR体验。
新专利	苹果	新专利：可以识别放在显示屏上的签名。
新专利	苹果	新专利：全屏指纹解锁，保留人脸识别。
新专利	苹果	新专利：HomePod可以自动重置音量。
新专利	苹果	新专利：苹果未来或推出便于携带又降噪的耳机。
新专利	LG	透明可折叠手机设计获美国专利。
新专利	微软	新专利：增加磁块平板模式让Type Cover更贴合背面。
新专利	OPPO	新升降+翻转摄像专利曝光。
新专利	中兴	手机新专利：像翻盖一样的屏内折叠手机。
新专利	三星	获DeX Live专利，Note10或将可无线连接显示器。



# SIIP CHINA

【SEMI产业创新投资平台-SIIP CHINA】是依托SEMI全球产业资源，汇聚全球产业资本、产业智慧搭建的专业而权威的产业投融资交流平台。SIIP CHINA产业创新投资平台，旨在推进中国半导体产业可持续发展，提供全球技术与投资对接机遇，促进中国与全球合作伙伴的协作，寄期望平台成为大半导体业界最具影响力的产业投资平台。



## 联系我们

SEMI中国 Lily Feng  
Tel: +86-21-60278500  
E-MAIL: lifeng@semi.org  
<http://www.semi.org.cn/siip>

**订阅半导体产业新闻半月刊（精华版）欢迎来信索取**  
(来信请附名片并注明公司名称、职务、联系电话)  
SEMI中国 Lily Feng  
E-MAIL: lifeng@semi.org

